

# Gudeng Precision Industrial Co. Ltd

## 家登精密工業股份有限公司



Partner with **H.E.A.R.T.** , Grow with **P.A.S.S.I.ON.**

發言人：朱佳琳  
電話：(02)2268-9141  
郵件：[Lynn.Chu@gudeng.com](mailto:Lynn.Chu@gudeng.com)

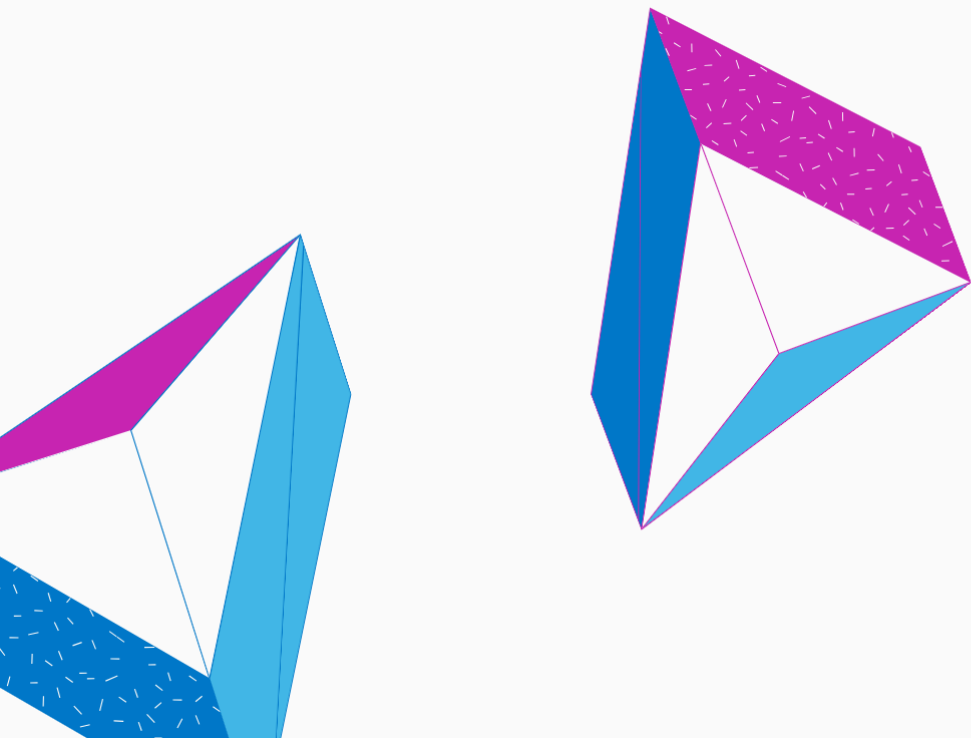


# 免責聲明

本資料可能包含對於未來展望的表述，是基於對現況的預期，但同時受限於已知或未知不確定性的影響，實際結果將可能於表述內容不同，以上所提供之所有資訊僅供參考，實際資料請參考公開資訊觀測站。

另除法令要求外，公司並無義務因應新資訊的產生或未來事件的發生，主動更新對未來展望的表述。

# 大綱



1

公司概況

2

光罩載具解決方案

3

晶圓載具解決方案

4

先進封裝解決方案

5

航太產品解決方案

6

營運成果



# 公司概況





# 家登-先進載具設備領航者



美國家宇

美國家登/德鑫半導體

韓國家登

日本家登

家登土城總部  
家崎科技  
家登創投  
家登復興廠

協力廠重慶廠

上海

家登昆山廠

上海家謙

台中

碩頂精密

家碩科技

台北

家登樹谷廠

台南

朝宇航太

岡山

- 成立於：1998年3月20日
- 員工數：1300 up
- 實收資本額：NT 960,392,390
- 集團2021營業額：NT 31.2 億元
- 集團2022營業額：NT 44.9 億元
- 集團2023營業額：NT 50.8 億元
- 集團2024營業額：NT 65.5 億元
- 集團2025營業額：NT 73.4 億元
- 集團2026 1~4月 營業額：NT 27.5 億元 20% ↑
- 主力產品：

## 半導體事業

- ① 光罩傳載解決方案
- ② 晶圓傳載解決方案
- ③ 先進封裝傳載解決方案
- ④ 半導體機台設備

## 航太事業

- ① 動力液壓阻尼油缸
- ② 液壓傳輸高壓導管
- ③ 動態平衡馬達基座
- ④ 正負壓熱傳導隔片



# 家登擴廠進度



● 家登精密  
● 重要客戶

## 日本久留米廠

海外備援廠區

2026年年底完成主建物

- 光罩載具全系列
- 晶圓載具全系列

德國德勒斯登廠  
ESMC

## 昆山廠 / 重慶協力廠

大中華在地供應鏈

- 成熟製程光罩載具
- 晶圓載具全系列

大中華客戶群

Samsung / Hynix

TSMC熊本廠  
Fab23(P1~P2)

TSMC嘉科廠  
AP6~AP7

TSMC台南廠  
Fab18(P1~P9)  
AP5 - AP8

TSMC高雄廠  
Fab22(P1~P4)

TSMC新竹/龍潭廠  
Fab20(P1~P4)  
AP1~AP3

## 復興廠

北區生產中心、模具加工中心

家崎大樓

家崎生產基地暨研發總部

- 半導體載具加工
- Cooling解決方案

TSMC亞利桑那廠  
Fab21(P1~P3)  
AP9~AP10

Parker / Boeing /  
GE / Honeywell

## 美國子公司

倉辦、FAE、NC加工產線

2026 Q4 試量產

- 航太及半導體零組件生產
- 當地客戶服務

## 家登樹谷廠 P1/ P2

主要生產基地

- 光罩載具全系列
- 晶圓載具全系列
- 先進封裝載具全系列

## 南科三期

家碩生產基地

2026年6月完工

- EUV光罩相關機台
- 自動化及檢測設備

家登精密



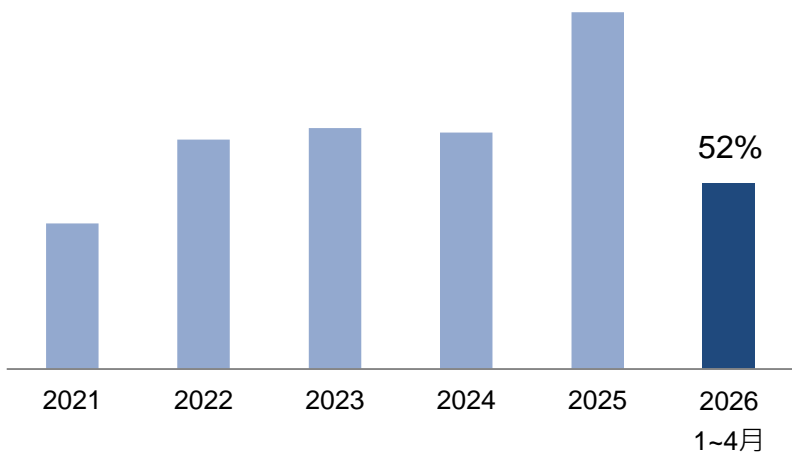
# 光罩載具解決方案



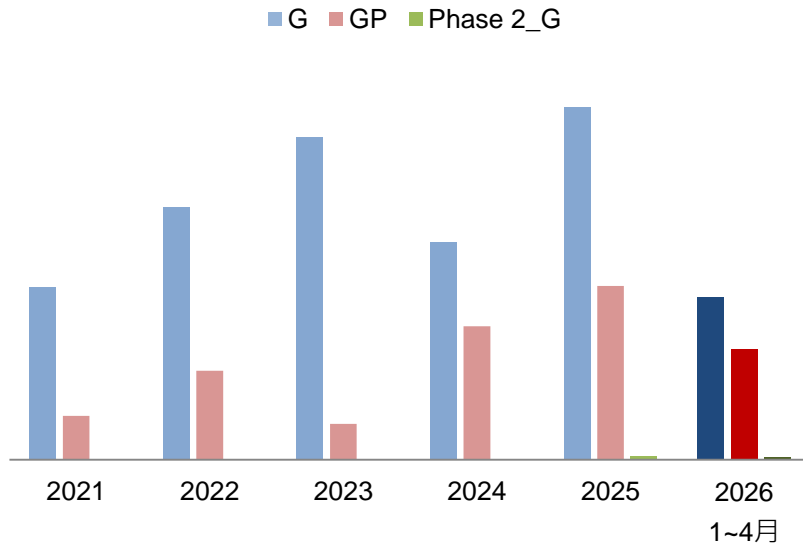


家登精密

## EUV Pod



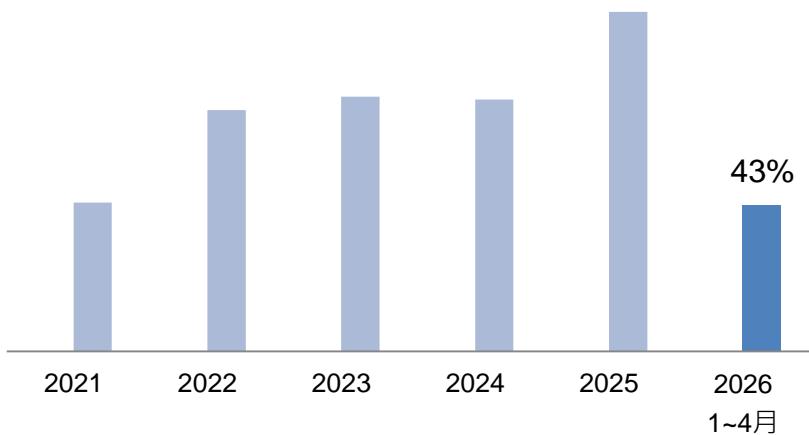
## EUV G/GP



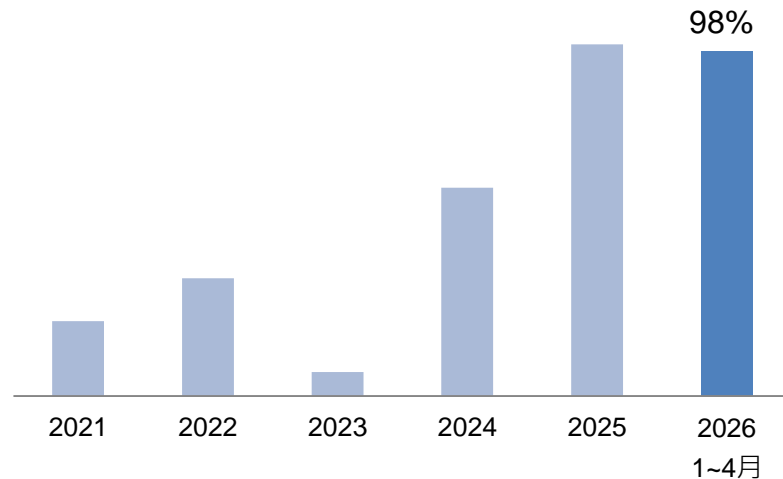


家登精密

## 台灣 EUV Pod



## 海外 EUV Pod



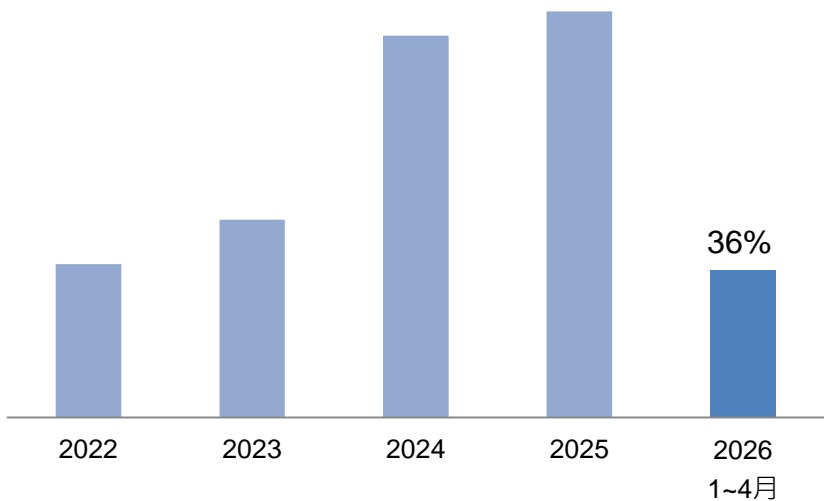


# 晶圓載具解決方案

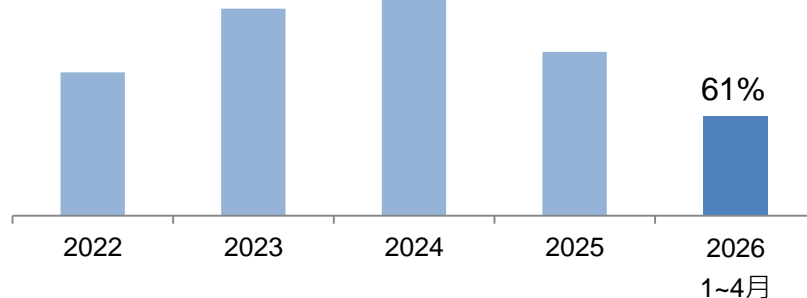




## FOUP



## 大中華 FOUP





# 先進封裝解決方案





# 先進封裝技術-家登全系列解決方案



Chip on Wafer  
Chip on Panel

*Silicon Interposer*



**Frame FOU**  
台灣 美國 韓國



**Diffuser FOU**  
P300 FOU  
台灣



**Chip on Panel FOU**  
Chip on Panel FOSB  
台灣 美國

on Substrate

*ABF / CCL*



**Panel FOU**s  
• 5XX\*6XX  
韓國



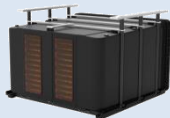
**Panel FOU**  
• 510\*510  
• 510\*515 台灣

FoPLP

*Glass Interposer*

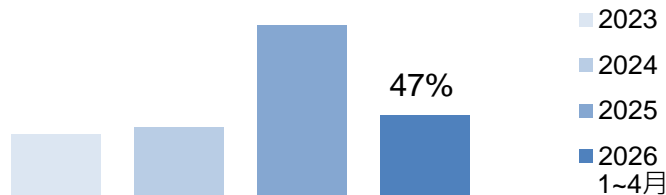


**Quarter Panel FOU**  
• 310\*310 台灣  
• 300\*300 大中華  
• 243\*241 美國  
• 240\*241  
• 247\*246  
• 247\*163



**Panel FOU**  
• 510\*515  
• Large Tray  
韓國 日本  
大中華 美國

先進封裝載具歷年營收



與子公司-碩頂精密 合作開發

家登精密



# 航太產品解決方案



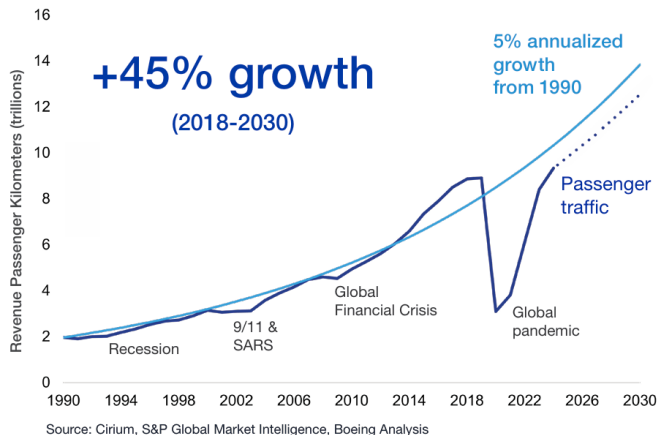


# 航太市場及營收表現



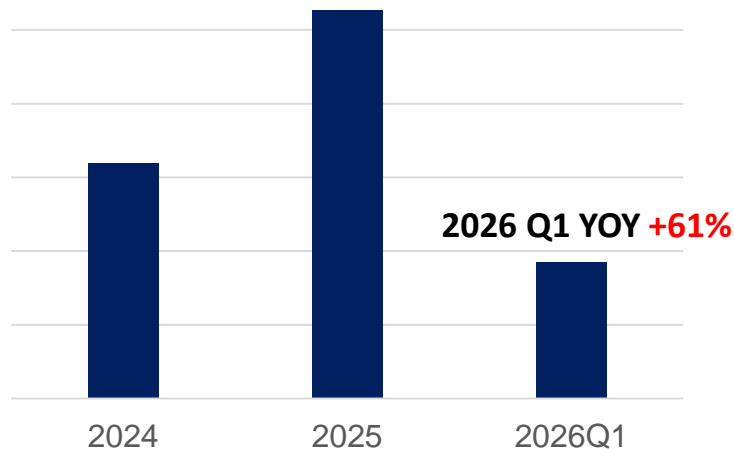
家登精密

Aviation's resilience is proven; this is a growth industry



## 航太市場疫後的強勁反彈

2025 全年 YOY **+60%**



## 家登航太事業近三年營收 持續高成長態勢



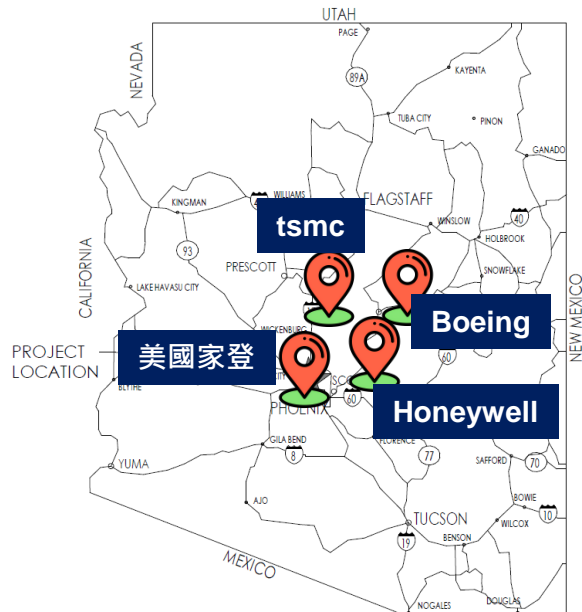
## Why U.S.

支持航太供應鏈在地化需求  
強化家登國際航太客戶服務能力

- 降低地緣政治與關稅風險
- 強化與航太大客戶合作
- 航太供應鏈在地化
- 發展企業持續營運計畫

**目標2026 Q4營運**

## 坐落航太及半導體心臟聚落 Phoenix, Arizona





# 營運成果





# 綜合損益表 YOY

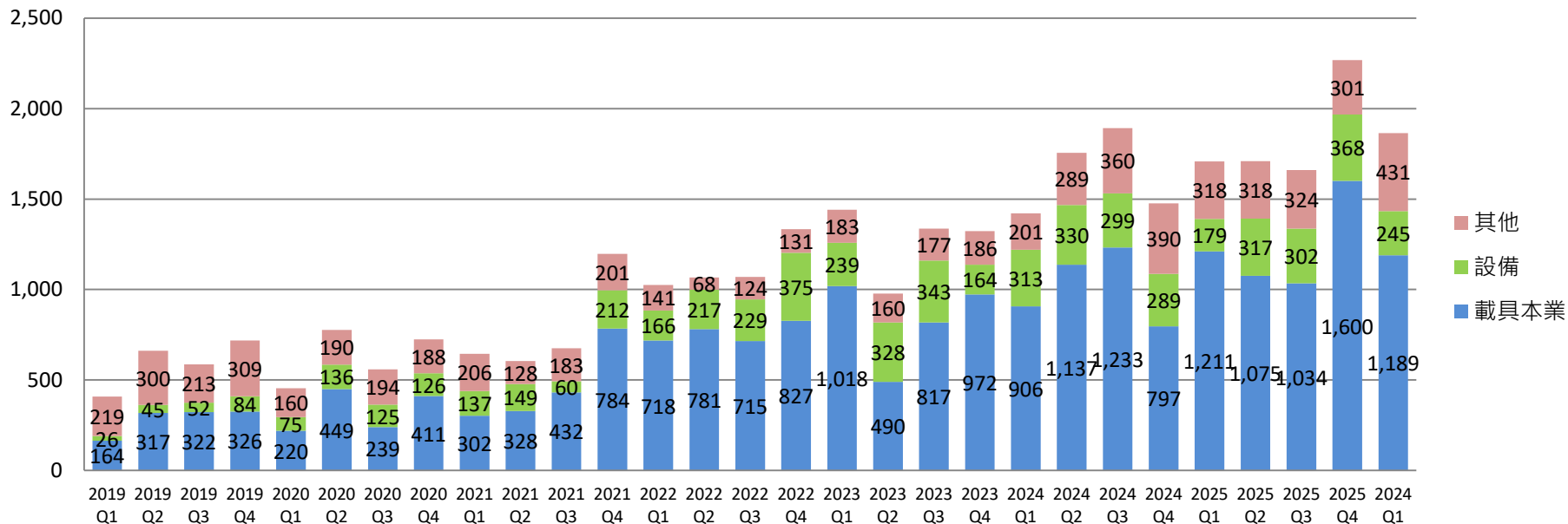


	2026 Q1		2025 Q1	
營收	1,865,049	100%	1,708,796	100%
成本	1,069,923	57%	961,150	56%
毛利額	795,126	43%	747,646	44%
費用	503,694	27%	445,567	26%
淨利	291,432	16%	302,079	18%
營業外收入 及支出	46,921	3%	(14,317)	-1%
稅前淨利	338,353	18%	287,762	17%
本年度淨利	278,153	15%	220,245	13%
EPS	2.54		2.19	

新台幣千元



## 家登集團合併營收

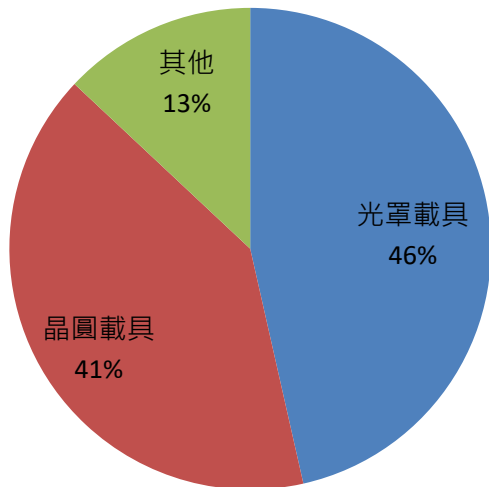


百萬元

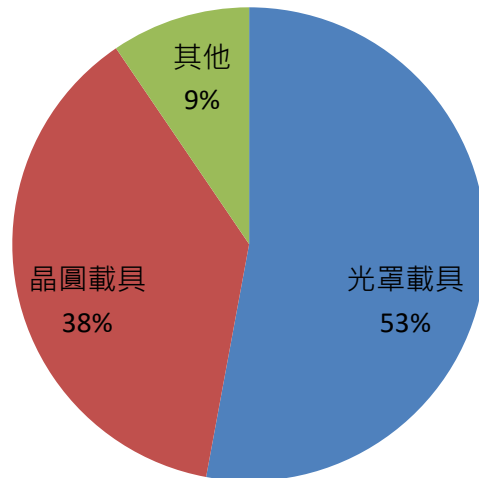
家登精密



## 2024



## 2025

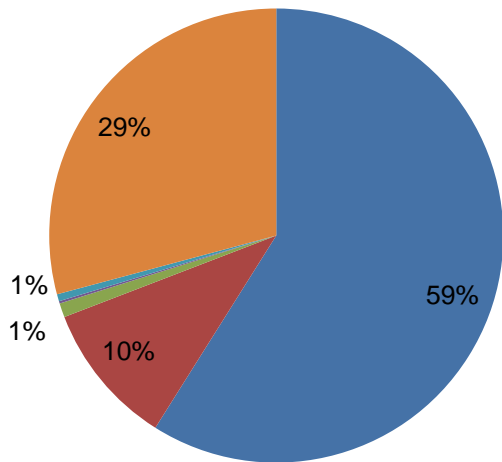




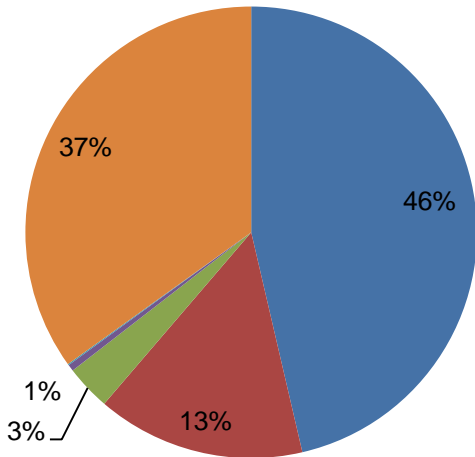
# 家登本業營收地區表現



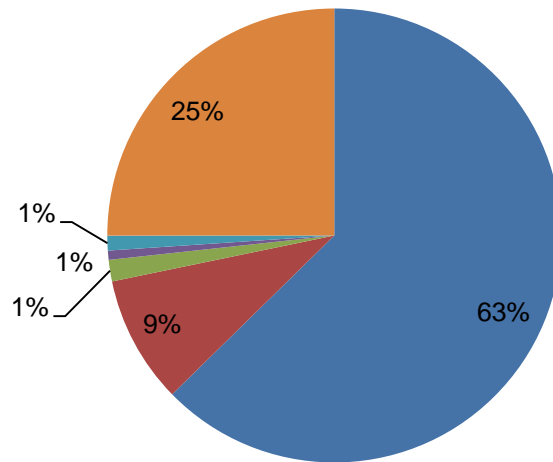
2023



2024



2025



■ 台灣 ■ 美國 ■ 日韓 ■ 其他 ■ 歐洲 ■ 大中華

家登精密



# 家登集團2026大中華市場版圖



## 山東省

- 芯恩 (青島)
- 物元 (青島)
- 濟南泉意
- 濟南擎方

## 浙江省

- 富芯半導體
- 杭州士蘭
- 浙江創芯
- 長電紹興
- 杭州積海

## 重慶市

- 重慶萬國
- 重慶芯聯
- 潤西微電子

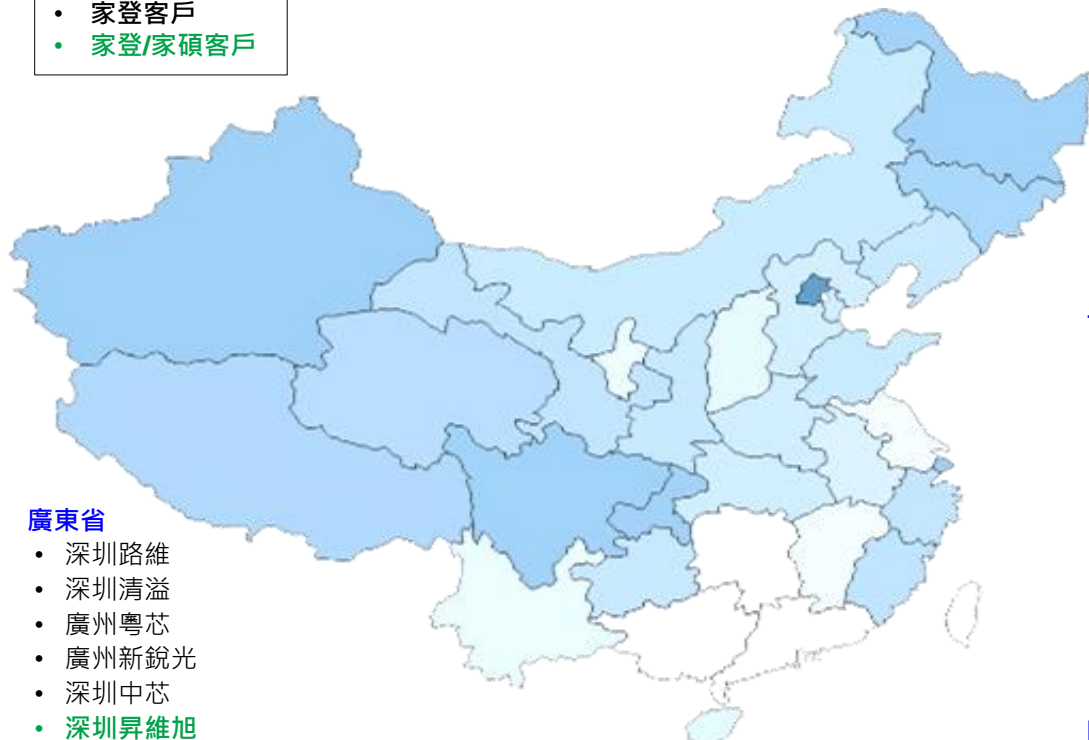
## 江蘇省

- 南京台積
- 無錫卓勝微
- 矽品科技(蘇州)
- 江蘇芯德
- 無錫中微
- 無錫迪斯
- 無錫海力士
- 長電先進
- 蘇州和艦

- 家登客戶
- 家登/家碩客戶

## 廣東省

- 深圳路維
- 深圳清溢
- 廣州粵芯
- 廣州新銳光
- 深圳中芯
- 深圳昇維旭
- 深圳鵬新旭
- 深圳鵬芯微
- 東莞光茂



## 遼寧省

- 大連海力士

## 北京市/天津市

- 北京中芯
- 長鑫集電
- 北京燕東
- 永芯科技
- 北京賽萊克斯
- 天津中芯

## 湖北省

- 武漢新芯
- 武漢楚興
- 武漢高芯
- 長江存儲

## 安徽省

- 合肥晶合
- 合肥視涯
- 合肥清溢
- 長鑫新橋
- 長鑫存儲
- 聚合微

## 福建省

- 廈門士蘭
- 廈門聯芯
- 廈門美日
- 渠梁電子
- JHICC(晋华)

## 上海市

- 中芯國際
- 台積電-十廠
- 先進半導體
- 上海凸版
- 積塔半導體
- 上海新昇
- 上海超硅
- 上海集成
- 上海光通信
- 天盛方儲
- 芯曜鑫

## 陝西省

- 西安奕斯偉



## 光罩載具

- ✓ 2025年Q3完成RSP系列昆山產地技轉
- ✓ 光罩廠出貨盒 90%以上使用家登
- ✓ 新建廠 RSP150 70%以上使用家登
- ✓ 切入供貨Blank廠載具，26年顯著挹注營收
- ✓ 2026年光罩載具整體營業額顯著成長



## 晶圓載具

- ✓ 26年Q3完成高階FOUP昆山產地技轉
- ✓ 客戶加大資本支出，2026年晶圓載具營收較2025年顯著成長
- ✓ 取得60%以上新建廠Baseline FOUP訂單，高階FOUP佔比高，營收貢獻強



## 先進封裝載具

- ✓ 成為大尺寸面板級封裝研發新廠大客戶主力合作夥伴
- ✓ 2.5、3D封裝載具放量出貨，2026年顯著挹注營收
- ✓ 大中華市場CoPoS載具最大供應商，2026年成長可期

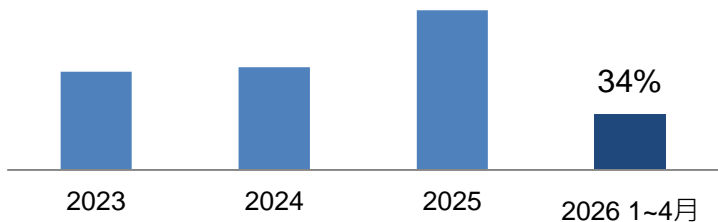


# 家登本業地區營收趨勢

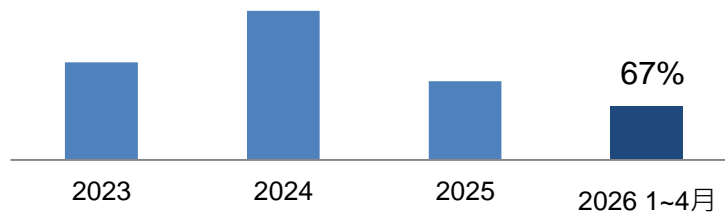


家登精密

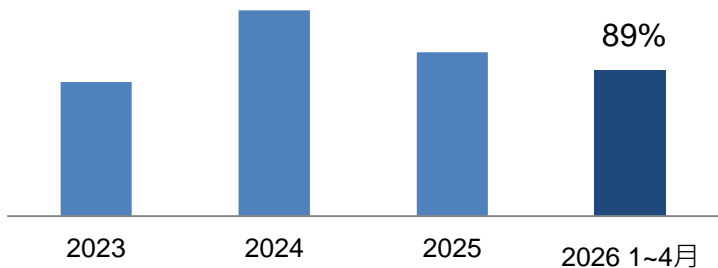
## 台灣



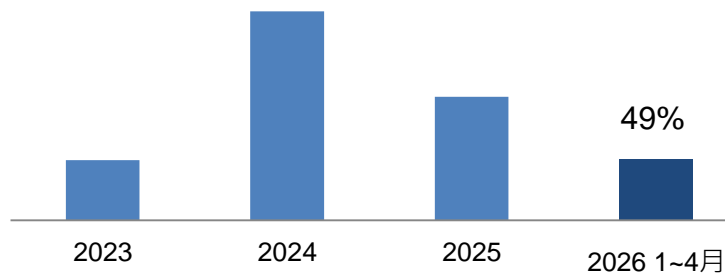
## 大中華



## 美國

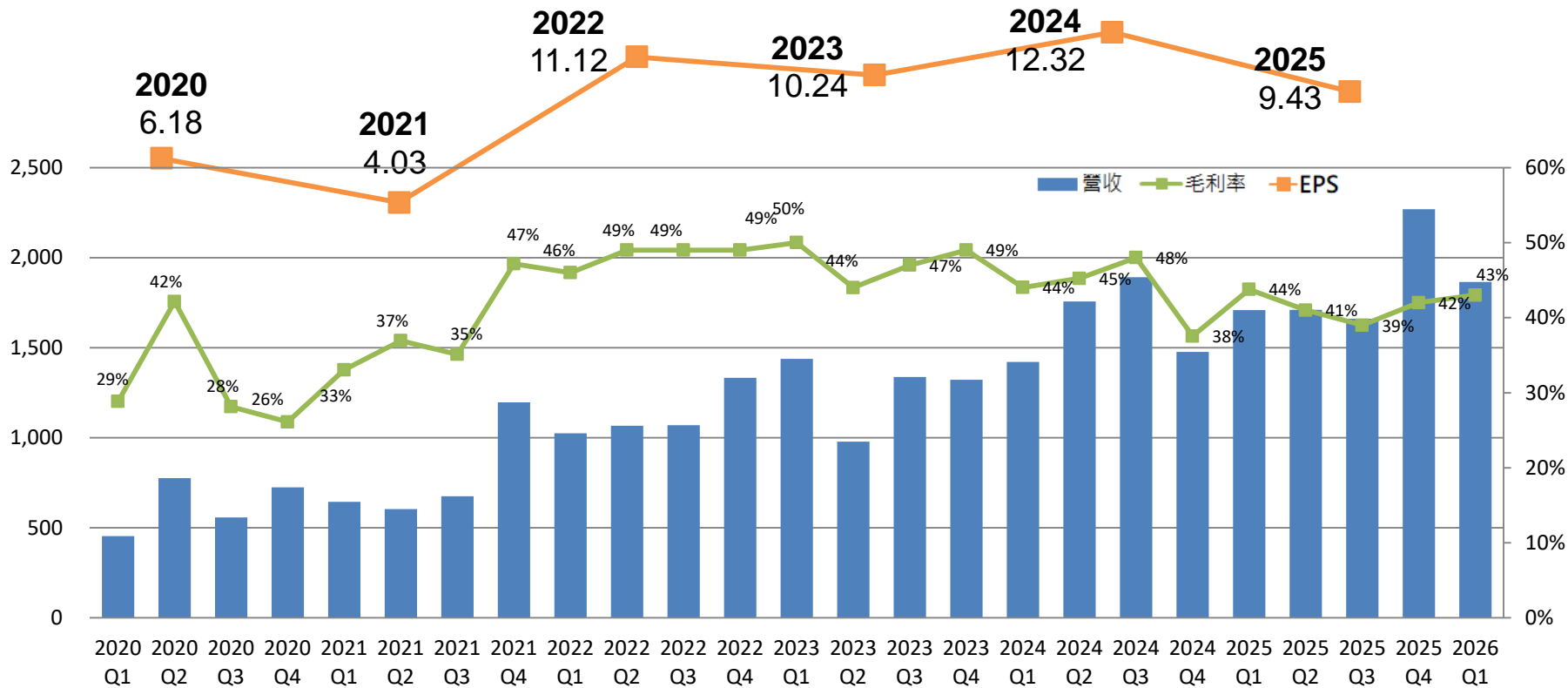


## 日韓





# 家登集團每季毛利



家登精密

百萬元



# 家登ESG實踐績效



## ENVIRONMENTAL

單位營收碳排量 2024 年減少 **45%**  
 單位營收用水量 2024 年減少 **67%**  
 單位營收廢棄物 2024 年減少 **25%**  
 (皆以2021年為基期)

- 國際可持續發展與碳認證 (ISCC PLUS)
- ISO 50001 驗證聲明書
- CDP: Climate Change **B**  
Water Security **A-**  
SEA **A-**



## SOCIAL

2024 年員工平均薪資 **19** 個月  
 2024 年創造 **270** 個優質工作機會  
 2024 年人均薪資福利費用 **796,000** 元

- 2024年投入 **20** 項社會公益行動，累計  
效益達 **646** 萬元



外資精選台灣百強  
 TCSA永續報告書獎  
 台灣百大永續典範企業  
 天下永續公民獎

## GOVERNANCE

2025 年 集團營收 **73.4**億元  
 2025 年 EPS **9.43**元  
 2024 年 公司治理評鑑 **6-20%**

- 客戶滿意度調查 **95** 分
- ISO 20400 永續採購指南認證
- RBA 行為準則 **銀級**
- TTQS人才發展品質管理系統 **銀級**
- TIPS 台灣智慧財產管理制度 **A級**

家登永續報告書





**Thank You**  
[www.gudeng.com](http://www.gudeng.com)